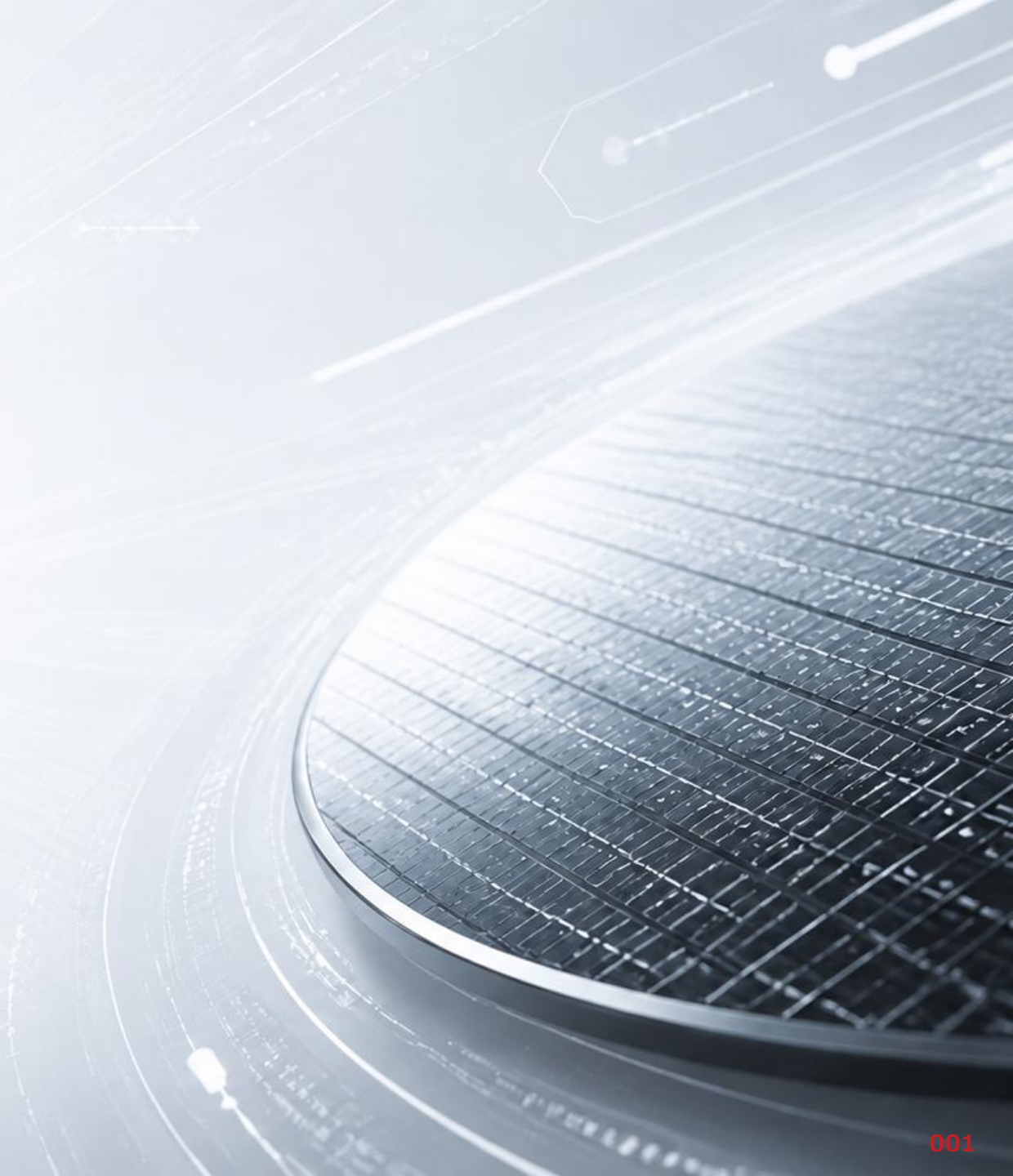
KAYOU
Accelerating progress through technology !

市場調査レポート

華陽
SiC産業レポート

2026年上半期

世界の動向と中国市場の構造変化



華陽株式会社

目次

トピックス・調査概要・国際動向・中国SiC産業構造

01 トピックス 005–008

重要ニュース10件の総覧 006
重要ニュースの詳解 007–008

02 調査概要 009–014

経営・営業上の論点 010
供給・需要・価格の確認指標 011
上期の変化と下期の確認事項 012
バリューチェーンと企業の事業範囲 013
対象期間・地域・数値区分 014

03 国際動向 015–021

世界市場の成長シナリオ 2020–2035 016
用途別需要と地域別生産 017
欧州・北米・日本・中国の動向 018–021

04 中国SiC産業構造 022–028

材料から最終用途までの企業・役割 023
独立材料・IDM・受託の取引構造 024
国内供給・輸入・海外生産 025
売上・生産・出荷の変化 026
在庫・稼働・価格と上期総括 027–028

章見出しと小見出しのページは、本資料の通し番号に対応。

目次

SiC基板・SiCエピウエハ

05 SiC基板 029–055

四半期能力推移・8インチ化 030
メーカー別能力配置・算定方法 031–032
出荷基準と径別・企業別出荷推計 033–036
出荷構成・稼働率・整合性 037–039
期後更新：納期・価格の観測 040
価格参考系列・メーカー別情報 041–042
価格形成・調達予算レンジ 043–044
6／8インチの購入比較 045
価格シナリオ：2026年末～2030年 046
中国の協業・投資・資金調達 047–050
SST・先端実装・車載の技術展望 051–055

06 SiCエピウエハ 056–070

中国の四半期能力推移 057
世界の商用供給能力シェア 058
企業別の6／8インチ有効能力 059
能力・稼働率の比較と四半期推移 060–061
企業別供給構成・稼働率推移 062–063
出荷・内部供給量の条件試算 064
調達予算・価格の推移 065–066
中国／海外の販売地域構成 067
チップ原価とエピウエハの役割 068
国際協業と販売拡大の条件 069–070

章見出しと小見出しのページは、本資料の通し番号に対応。

目次

SiCパワーデバイス・SiCパワーモジュール・アプリケーション

07 SiCパワーデバイス 071–094

- 中国の量産供給と車載調達の課題 072–073
- 国産化の時間軸と海外企業の機会 074
- 中国系世界シェア・生産量シナリオ 075–076
- 6／8インチのファブ能力配置 077–081
- 産業構造・稼働率・出荷推計 082–084
- 用途別需要と2026～2027年見通し 085–086
- 企業別ウエハ投入量と用途構成 087–089
- 新用途需要・AIDCと車載の比較 090–091
- トレンチ・スーパージャンクション 092
- MOSFET／SBDの価格と年末予測 093–094

08 SiCパワーモジュール 095–107

- IGBT／SiC構成と中国の国産化 096–097
- メーカー別搭載量・市場構造 098–099
- 主要OEMのモジュール／チップ供給 100–101
- 価格・原価・収益構造・粗利率 102–104
- 中国の投資・協業と海外大手動向 105–107

09 アプリケーション 108–124

- 需要全景・技術と電圧のロードマップ 109–110
- 中国NEVの販売・採用率・高電圧化 111–113
- Xiaomi・ZEEKR・BYDの車種事例 114–116
- 太陽光・蓄電・風力・送電 117–118
- AIDCの電力コスト・需要・新技術 119–121
- 家電・産業電源の採用と参入機会 122–123
- 先端実装の放熱・AR光学材料 124

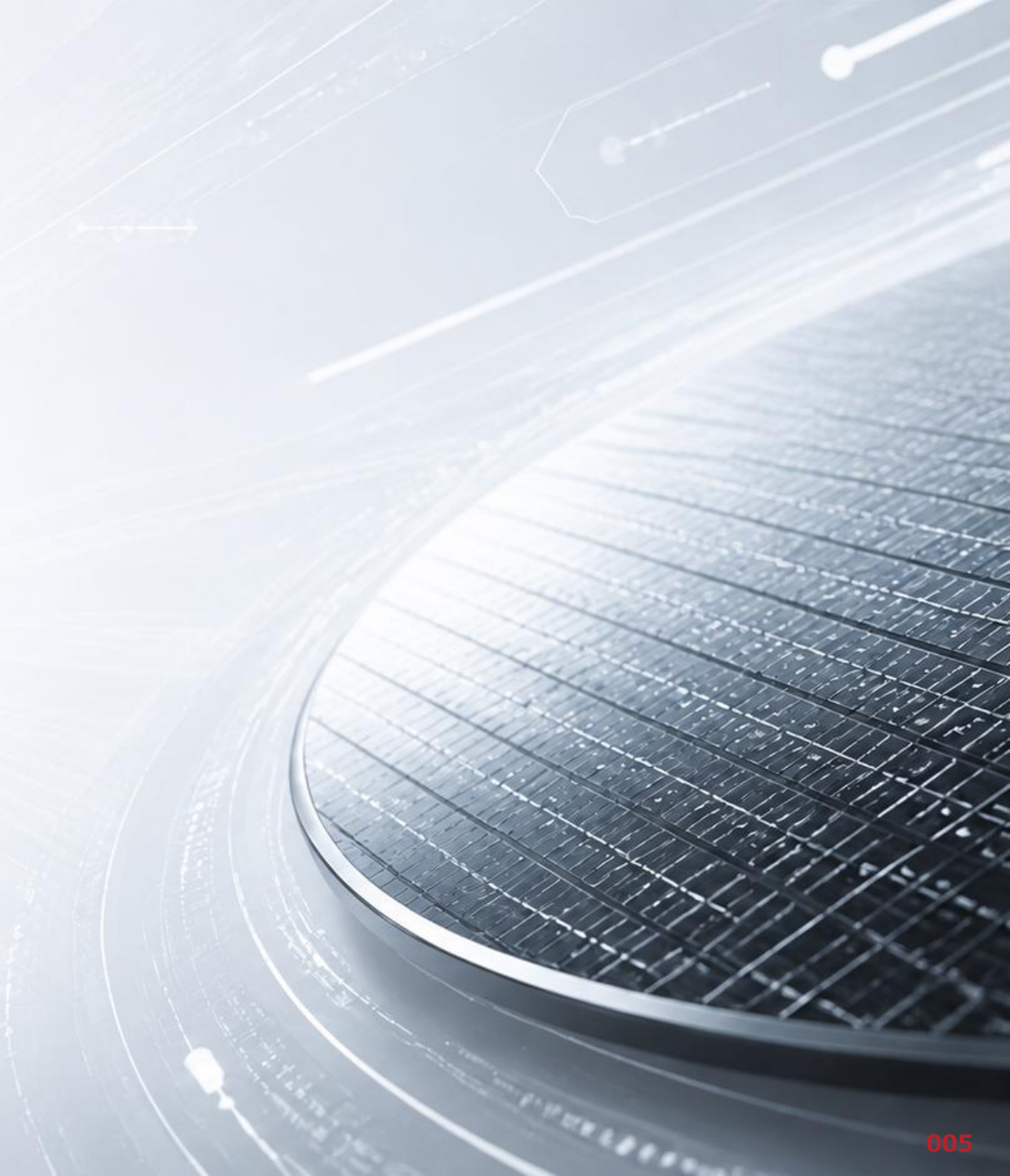
章見出しと小見出しのページは、本資料の通し番号に対応。

KAYOU
Accelerating progress through technology !

トピックス

華陽 SiC産業レポート

2026年上半期



KAYOU
Accelerating progress through technology !

2026年上半期、SiC産業を動かした10の重要ニュース

材料・量産体制・製品・需要接点の変化を、確認できる事実から整理

01 東芝・ROHM・三菱電機が統合協議へ

03.27 半導体・パワーデバイス事業のMoUを締結。統合の条件・詳細は未決定。

02 ST、伊中の200mm SiC製造を始動

第2四半期 カターニアと重慶で製造を開始。7月公表の資料で上期の実施を確認。

03 Bosch、独SiC生産を200mmへ移行

05月 ロイトリンゲンで150mm SiC生産を終了し、200mmに全面移行。

04 Wolfspeed、300mm単結晶SiCを発表

01.13 単結晶ウエハの作製成功を公表。300mm商用量産の発表ではない。

05 ROHM、第5世代SiC MOSFETを開発

03月 3月に開発完了、4月に公表。175℃でオン抵抗を約30%低減と発表。

06 Geely・onsemi、900V車で協業を拡大

04.28 SEA-SベースのSEPシステムにEliteSiC技術を組み込むと発表。

07 Infineon、SiC-SSTで提携

03.24 DG MatrixのInterport向けにSiCを供給。AI電源インフラが対象。

08 Wolfspeed、10kV SiCを商用化

03.05 10kV耐圧のパワーMOSFETを発表。中電圧電源・SSTなどを想定。

09 Epiworld、香港上場でエピ投資へ

03.30 純調達額は約15.6億香港ドル。71%をエピ生産能力拡充に充てる計画。

10 TYSiC・青禾、接合SiC基板で提携

01.16 8インチ接合SiCと、12インチ以上の複合放熱基板を協業対象に。

対象：2026年1–6月。確認基準：2026.10.30。華陽の編集選定・順不同。数値・計画は各社公表に基づく。

KAYOU
Accelerating progress through technology !

お問い合わせ

中国SiC市場の情報・調達・事業連携のご相談

華陽株式会社

代表取締役社長 CEO　陳 ユタカ / Chin Yutaka

E-mail　chin.yutaka@kayou.co.jp

Web　www.kayou.co.jp

TEL（日本）　+81 90-8321-0916

TEL（中国）　+86 177-1553-0321

次号のご案内

華陽 SiC産業レポート　2026年第3四半期版

2027年2月 発行予定

製品・サービスのご案内

製品情報はこちら